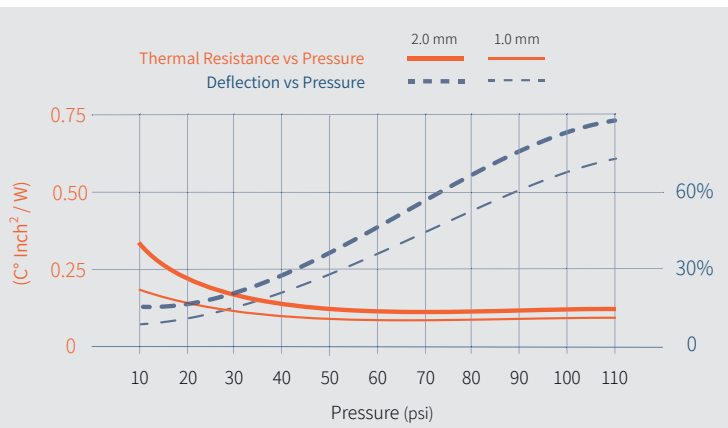


# Thermal Interface Material Silicone Gap Filler



**Klebeschicht** (Stärke: 0.03 mm)  
Adhesive layer (Thickness: 0.03 mm)  
A1 = einseitig / one side  
A2 = beidseitig / both sides

**Verstärkung**  
Reinforced layer  
V = mit / with

**Materialstärke**  
Material thickness  
1.00 = 1.00 mm

DS-GAP-NOS30-5.0-LO-X.XX-X-X

## DS-GAP-NOS30-5.0-LO

<b>Wärmeleitfähigkeit<sup>1</sup></b> Thermal Conductivity <sup>1</sup>	W/mK	5.00
<b>Härte<sup>2</sup></b> Hardness <sup>2</sup>	Shore 00	30
<b>Einsatztemperatur<sup>3</sup></b> Operation Temperature <sup>3</sup>	°C	-40 / +150
<b>Materialstärke</b> Material Thickness	mm	0.50 - 5.00
<b>Durchschlagsfestigkeit<sup>4</sup></b> Dielectric Strength <sup>4</sup>	kV/mm	5.00
<b>Verstärkung</b> Reinforced Layer	√	optional
<b>Konformität</b> Conformity	√	RoHS
<b>Brandklassifikation<sup>5</sup></b> Flamability Class <sup>5</sup>	√	UL 94V-0
<b>Ausgasung (TML)</b> Outgasing (TML)	-	0.04%

1 ASTM D5470 2 ASTM D2240 3 EN344 4 ASTM D149 5 For 0.25mm thickness between PCB and Al-Plate

REV2017\_01

Technische Änderungen vorbehalten, alle technischen Daten und Angaben unverbindlich.  
Subject to technical alterations, all technical data and details are not binding.